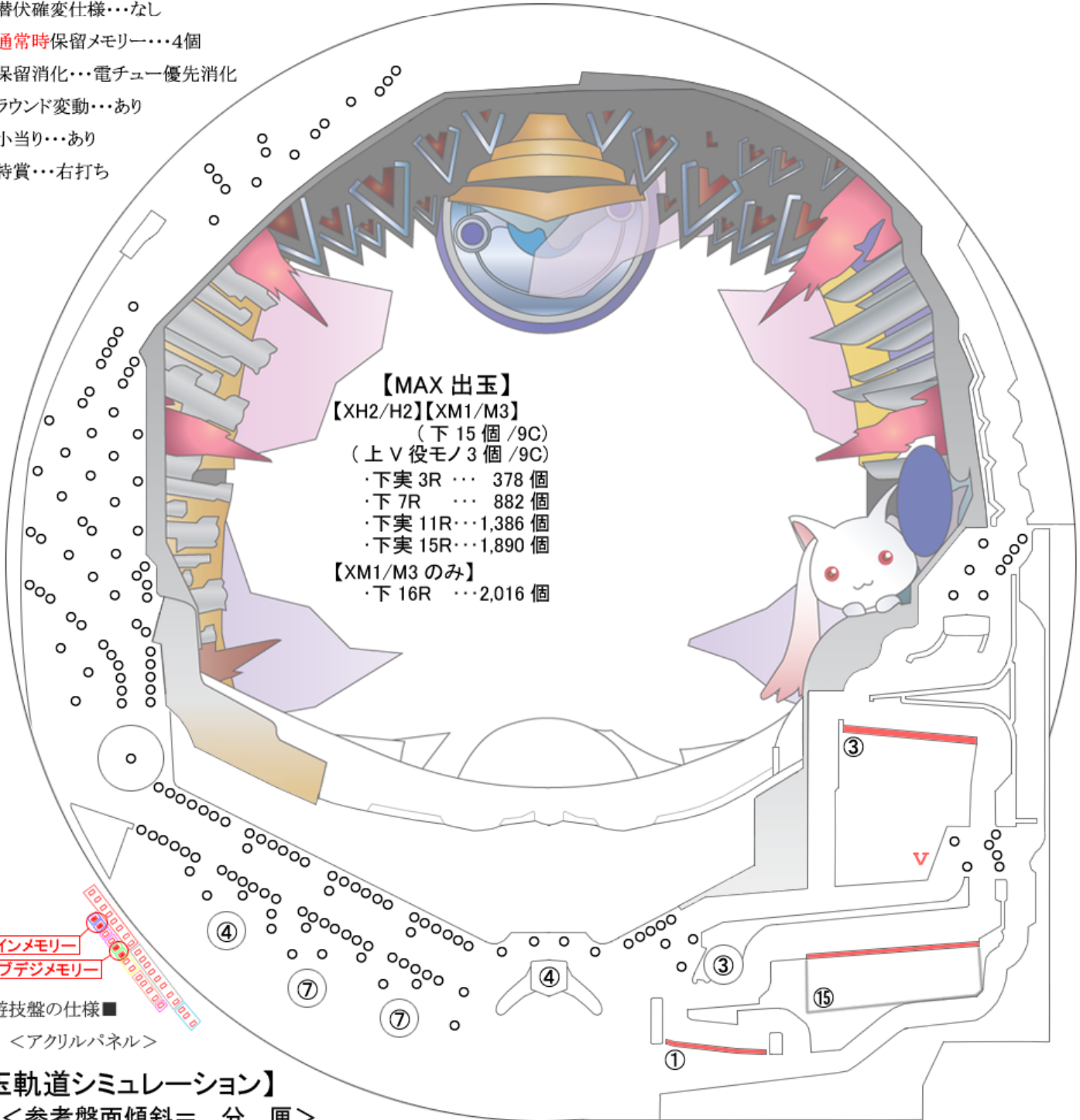


【XH2/H2】 確率=1/319.7 時短=100.0% 電サポ=時短中/1/6/次回 賞球=4&1&3&4&7&3&15
 【XM1/M3】 確率=1/228.4 時短=100.0% 電サポ=時短中/1/7/次回 賞球=4&1&3&4&7&3&15

- 機種タイプ...1種2種混合
- 潜伏確変仕様...なし
- 通常時保留メモリー...4個
- 保留消化...電チュー優先消化
- ラウンド変動...あり
- 小当たり...あり
- 特賞...右打ち



【MAX 出玉】
 【XH2/H2】【XM1/M3】
 (下 15 個 /9C)
 (上 V 役モノ 3 個 /9C)
 ・下実 3R ... 378 個
 ・下 7R ... 882 個
 ・下実 11R...1,386 個
 ・下実 15R...1,890 個
 【XM1/M3 のみ】
 ・下 16R ... 2,016 個

メインメモリー
サブデジメモリー

■遊技盤の仕様■

<アクリルパネル>

【玉軌道シミュレーション】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|--|--|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検
 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p>B : 主基板等の点検
 4:主基板のケース異常・開封
 5:主基板の形状異常・異物
 6:払出基板のケース異常・開封
 7:払出基板の形状異常・異物
 8:ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検
 9:周辺基板・10:中継端子板
 11:外部端子板・13:コネクタ
 12:ユニット接続端子板・14:配線
 15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車
 17:上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認)
 18:タッチセンサー作動確認
 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認)
 21:入賞賞球数・22:最大入賞数
 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検
 25:全ての接続箇所点検
 26:スピーカーの作動確認
 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|